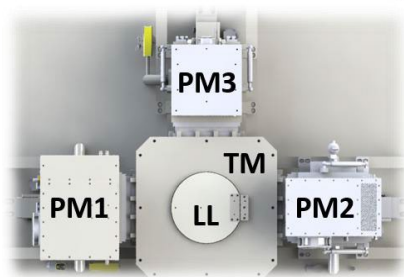


ALD / ALE・先端プラズマプロセス装置

原子層レベルのプロセス開発を、柔軟な装置構成で

研究開発・新材料評価・次世代半導体プロセス向けカスタムソリューション



PM: Process Module
TM: Transfer Module
LL: Loadlock

(Sample image)

研究テーマに合わせて 「装置を組む」

ALD, ALE, RIE, CVD, Cryogenic RIE, RTP
などのプロセスに対応。

4～12インチの基板サイズ、RF方式、
チャンバー構成、ローディング方式など、
研究目的やプロセス条件に応じたカスタ
マイズが可能です。

[研究テーマ・プロセス条件に合わせた
柔軟なシステム設計](#)

1 プロセスを選べる

ALE / ALD / CVD / RIE /
Cryogenic RIE / RTPなど、
テーマに応じたプロセス
構成

2 構成を拡張できる

スタンドアロンから最大
3PMのクラスターツール
まで。手動・自動ローデ
ィングを選択可能

3 研究用途に合わせ られる

4～12インチ基板、CCP /
ICP / RPS / RTPなど、
要求仕様に応じて構成可能

対応プロセス

ALD

ALE

RIE

Cryogenic RIE

CVD

RTP

次世代半導体・新材料研究のプロセス開発を支える Os Corporation

研究テーマに応じて選べる装置ラインナップ

スタンドアロンからクラスターツール、プリカーサー冷却まで

01 スタンドアロンALD



4～6インチ対応。シャワーヘッド方式、SUSチャンバー。壁面温度最大300℃、ステージ温度最大600℃。ロードロックによる完全自動ウェーハローディング、ガス用MFC最大5個、前駆体ライン最大4個。

薄膜形成・新材料・成膜プロセス開発

02 極低温 RIE / Plasma ALE



RIEまたはPlasma ALE対応。TCP (ICP) 方式。4インチ標準、8インチオプション。極低温冷却流路付きステージと真空断熱式極低温配管を備え、研究開発用途では最大-70℃チラーに対応。

低ダメージエッチング・微細加工プロセス研究

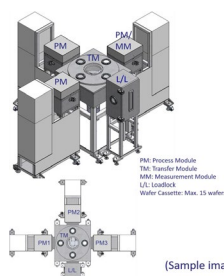
03 クラスターツール



ALE / ALD / CVD / RIE / Cryogenic RIE / RTP対応。最大3プロセスモジュール+ TM/LL。4～12インチ、CCP / ICP / RPS / RTPを要求仕様にに応じて構成。手動ウェーハローディング。

複数プロセスを組み合わせた一貫プロセス研究

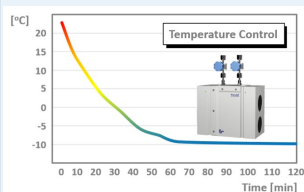
04 自動カセットローディング



最大15枚のカセットによる自動ウェーハローディングに対応。真空搬送ロボットとローディングアームを備え、複数プロセスを一つのプラットフォームへ統合可能。

プロセス評価・再現性検証・自動化研究

05 Precular™ キャニスタークーラー



高価で揮発性の高いプリカーサーの取り扱いを想定。

最大-10℃（500cc使用時）、手動またはRS-485制御。

250cc / 500ccほかサイズカスタマイズ対応。

研究員の方へ

研究開発テーマからご相談ください
「この材料でALDプロセスを検討したい」
「Plasma ALEによる低ダメージ加工を評価したい」
「既存装置では実現できないプロセス条件を試したい」
「ALD・ALE・RIEなど複数工程を一つのシステムで検討したい」

研究テーマ・プロセス条件・基板サイズなどをもとに、装置構成を個別に検討します。

温度管理を必要とする高価・高揮発性プリカーサーのプロセス研究

お問い合わせ・仕様相談

ネットコネクトプロ合同会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 414号室

TEL : 050-5873-0602 email : sales@ncpl.co.jp